

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-37

投资者关系 活动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 现场参观 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 其他 （<u>券商策略会</u>）
活动参与人员（排名不分先后）	永赢基金、华源证券、淡水泉投资、中邮证券、野村证券、Bakewell Capital Limited、Voya Investment Management、BOYU CAPITAL MANAGEMENT LTD、Sumitomo Mitsui DS Asset、中庚基金
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；证券事务主管：阳佩琴
时间	2025 年 11 月 12 日-13 日
地点	网络及电话会议、野村证券策略会
形式	网络及电话会议、实地调研
投资者关系 活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍公司 2025 年三季度经营业绩情况。 2025 年三季度，公司实现营业收入 63.01 亿元，同比增长 33.25%，归母净利润实现 9.66 亿元，同比增长 92.87%，扣非归母净利润累计实现 9.16 亿元，同比增长 94.16%。上述变动主要得益于公司把握 AI 算力升级、存储市场结构性增长、汽车电子智能化的需求增加的发展机遇，实现了主营业务收入的同比增长。其中，AI 加速卡、交换机、光模块、服务器及相关配套产品需求持续提升，存储类封装基板产品把握结构性增长机遇，订单收入进一步增加。公司加大各业务市场开发力度，产品结构优化、产能利用率提升，助益利润同比增长。 Q2、请介绍 2025 年三季度综合毛利率环比变化情况。 2025 年第三季度，公司综合毛利率环比有一定改善，主要得益于存储类封装基板需求增加，封装基板产能利用率提升，广州广芯工厂爬坡稳步推进，使得封装基板营收规模增长、

毛利率改善显著；同时，PCB 数据中心、有线通信业务收入持续增长，毛利率略有提升。上述因素共同助力公司综合毛利率的提升。

Q3、请介绍 2025 年第三季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。

公司 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2025 年第三季度，数据中心、有线通信业务收入持续增长，各业务领域占比与上半年基本一致。

Q4、请介绍 2025 年第三季度封装基板业务经营拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2025 年第三季度，封装基板营业收入环比增加，各下游领域产品需求均有增长，其中存储类封装基板增长最为显著。

Q5、请介绍公司 FC-BGA 封装基板产品技术能力及广州封装基板项目爬坡进展。

公司已具备 20 层及以下 FC-BGA 封装基板产品批量生产能力，22~26 层产品的技术研发及打样工作按期推进中。公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，主要承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单。近期各类订单逐步投入生产，广州封装基板项目在 2025 年第三季度亏损逐步缩窄。

Q6、请介绍公司南通四期及泰国项目规划及当前建设进展。

公司新建工厂包括南通四期及泰国工厂，泰国工厂目前已连线试生产，南通四期在今年四季度连线。南通四期和泰国工厂将具备高多层、HDI 等 PCB 工艺技术能力，其建设将助力 PCB 业务产能进一步释放。

Q7、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025 年三季度，受大宗商品价格变化影响，金盐、铜等部分原材料价格环比增长。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟

	通。 Q8、请介绍无锡新地块规划。 该地块为 PCB 业务算力相关产品的储备用地，预计分期投入，具体投资将根据业务发展和市场情况推进实施。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无